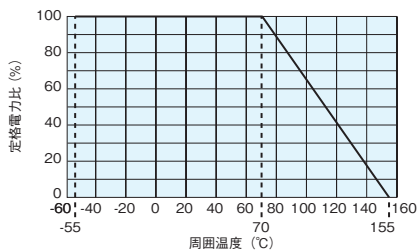




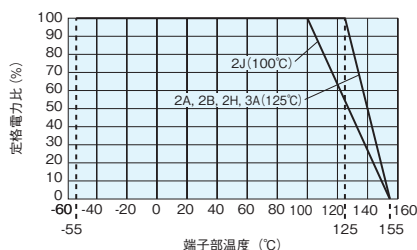
## ■ 負荷軽減曲線

周囲温度



周囲温度70℃以上で使用される場合は、上図負荷軽減曲線に従って、電力を軽減してご使用ください。

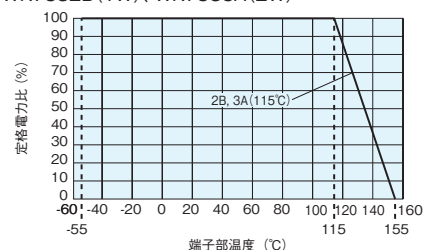
端子部温度



上記の定格端子部温度以上で使用される場合は、負荷軽減曲線に従って電力を軽減してご使用ください。ご使用方法につきましては巻頭の「端子部温度の負荷軽減曲線の紹介」を参照願います。

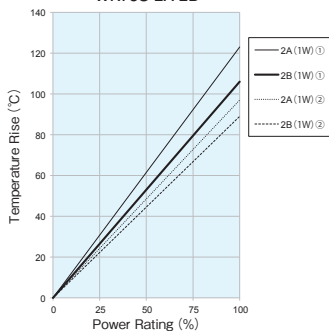
端子部温度

WK73S2B (1W)、WK73S3A (2W)

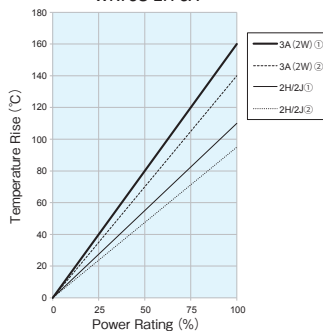


## ■ 温度上昇データ

WK73S 2A-2B



WK73S 2H-3A



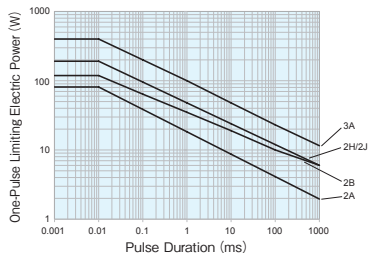
温度上昇については、弊社測定条件下で測定しているため、使用状況、使用基板により数値が異なります。

測定条件  
室温: 25℃  
基板仕様: FR-4相当 t = 1.6mm  
Cu箔厚: 35μm



## ■ ワンパルス限界電力曲線

WK73S 2A-3A



印加可能な電圧の上限は最高過負荷電圧になります。パルスを連続して印加する場合の耐性はお問い合わせください。本データは参考値ですので、ご使用の際は必ず実機での確認をしてください。

## ■ 性能

試験項目	規格値 ΔR± (%+0.005Ω)		試験方法
	保証値	代表値	
抵抗値	規定の許容差内	—	25℃
抵抗温度係数	規定値内	—	+25℃ / -55℃、+25℃ / +125℃
過負荷 (短時間)	2	0.2	定格電圧×2.5倍を5秒印加 (WK73S2A、WK73S2B (1W)、WK73S3A (2W)) 定格電圧×2.0倍を5秒印加
はんだ耐熱性	1	0.2	260℃±5℃、10s±1s
端子強度	1	0.1	たわみ強さ: 支持点間隔90mm、たわみ回数1回、曲げ5mm
温度急変	0.5	0.3	-55℃ (30min.) / +125℃ (30min.) 100 cycles
耐湿負荷	2	0.2	40℃±2℃、90%~95%RH、1000h 1.5時間 ON / 0.5時間 OFFの周期
70℃又は定格端子部温度での耐久性	2	0.2	70℃±2℃又は定格端子部温度±2℃、1000h 1.5時間 ON / 0.5時間 OFFの周期
高温放置	2 : J (±5%) 1 : another	0.5 : J (±5%) 0.2 : another	+155℃、1000h

## ■ 使用上の注意

- チップ抵抗器の基材はアルミナです。実装する基板との熱膨張係数の違いから、ヒートサイクル等の熱ストレスを繰り返し与えた場合、接合部のはんだ (はんだフィレット部) にクラックが発生する場合があります。WK73シリーズは自己発熱も大きいことより、周囲温度の変動が大きく繰り返される場合や、負荷のオンオフが繰り返される場合は、クラックの発生に注意が必要です。熱ストレスによるクラックの発生は、実装されるランドの大きさ、はんだ量、実装基板の放熱性等に左右されますので、周囲温度の大きな変化や負荷のオンオフのような使用条件が想定される場合は、十分注意して設計してください。
- 50mΩ以下の抵抗値においては、ランドパターンの大きさや接続のはんだの量により、はんだ付け後の抵抗値が変動することがあります。事前に抵抗値低下・上昇の影響をご確認の上、機器設計してください。